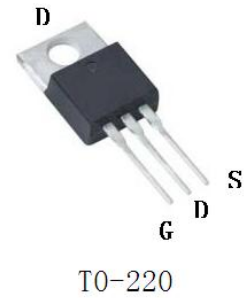


LYNM10N40TP (进口芯片) 型 N 沟道 MOS 场效应晶体管

特性

- 执行标准：QZJ840611, Q/RBJ1019QZ-2015
- 封装形式：T0-220AB
- 开关速度快，输入阻抗高，驱动功耗小，安全工作区宽，温度稳定性好



极限参数

- 贮存温度 T_{stg} : $-55^{\circ}\text{C} \sim 175^{\circ}\text{C}$
- 工作温度 T_{amb} : $-55^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
- 焊接温度不超过 260°C ，焊接时间不超过 10 秒

器件型号	额定功率 P_D (W)	漏源电压 BV_{DSS} (V)	栅源电压 V_{GS} (V)	漏极电流 I_D (A)	导通电阻 R_{DS} ($m\Omega$)	热阻 $R_{th(j-A)}$ (K/W)
LYNM10N40TP	300 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	400	± 20	10 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	4.8	62

主要电特性 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小值	典型值	最大值	
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=1mA$	400	—	—	V
零栅压漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS}=120V, V_{GS}=0V$	—	—	1	μA
		$V_{DS}=120V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}\text{C}$	—	—	100	μA
正向栅极漏电流	I_{GSSF}	$V_{GS}=20V, V_{DS}=0V$	—	—	100	nA
反向栅极漏电流	I_{GSSR}	$V_{GS}=-20V, V_{DS}=0V$	—	—	-100	nA
开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=230\mu A$	2	—	4	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=100A$	—	—	4.8	$m\Omega$
跨导	g_{FS}	$V_{DS}=10V, I_D=100A$	81	—	—	S
电容	C_{ISS}	$V_{DS}=60V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	—	—	12000	pF
	C_{OSS}	$V_{DS}=60V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	—	—	1530	pF

TO-220 封装外型图：

